

Title (en)

Galvanic bath for the electrodeposition of gold alloys.

Title (de)

Galvanisches Bad für das Elektroplattieren von Goldlegierungen.

Title (fr)

Bain galvanique pour le dépôt électrolytique d'alliages d'or.

Publication

**EP 0193848 A1 19860910 (FR)**

Application

**EP 86102442 A 19860225**

Priority

CH 94485 A 19850301

Abstract (en)

[origin: US4687557A] A galvanic bath for the electrolytic deposit of gold-based alloys contains a cyanide complex of gold, a cyanide complex of copper, a cyanide complex of cadmium and a cyanide complex of zinc, and at least one complexing agent and one surface-active agent, as well as, if desired, a depolarizing agent and/or an inorganic or organic brightening agent. This bath functions in the presence or in the absence of free cyanide.

Abstract (fr)

Ces alliages à base d'or, utilisables notamment pour le revêtement d'articles décoratifs, contiennent par exemple de 65 à 80 % en poids d'or, 10 à 25 % en poids de cuivre, 7 à 10 % en poids de cadmium et 0,2 à 0,6 % en poids de zinc. Un bain galvanique pour le dépôt électrolytique de ces alliages contient un complexe cyanuré d'or, un complexe cyanuré de cuivre, un complexe cyanuré de cadmium et un complexe cyanuré de zinc, et au moins un agent complexant et un agent tensio-actif, ainsi qu'éventuellement un agent dépolarisant et/ou un brillanteur inorganique ou organique. Ce bain fonctionne en présence ou en absence de cyanure libre.

IPC 1-7

**C25D 3/62**

IPC 8 full level

**C25D 3/62** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 3/62** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XP] EP 0140832 A2 19850508 - FINISHING SA H E [CH]
- [A] US 4179344 A 19791218 - THOMSON DONALD W [US]
- [A] AT 353071 B 19791025 - OXY METAL INDUSTRIES CORP [US]
- [A] FR 1572525 A 19690627
- [A] GB 2012306 A 19790725 - OXY METAL INDUSTRIES CORP

Cited by

EP2312021A1; EP0304315A1; US4980035A; EP1983077A1; EP3170924A1; US9567684B2; US9683303B2; US10233555B2; US10619260B2; EP3356579B1

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 0193848 A1 19860910; EP 0193848 B1 19890816**; CH 662583 A5 19871015; DE 193848 T1 19861218; DE 3665078 D1 19890921; US 4687557 A 19870818

DOCDB simple family (application)

**EP 86102442 A 19860225**; CH 94485 A 19850301; DE 3665078 T 19860225; DE 86102442 T 19860225; US 83208786 A 19860224